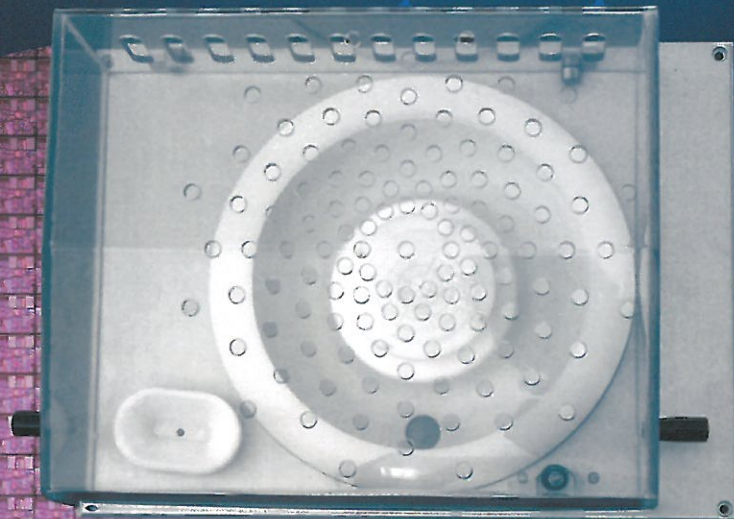


M-Spin 200 Belackungsschleuder

Die Belackungsschleuder M-Spin 200 dient zum homogenen Belacken und Trocknen von Wafern bzw. Substraten. Diese Belackungsschleuder ist für Wafer-Durchmesser bis zu 8" bzw. für Substrate bis zu 6" x 6" geeignet. Optional arbeitet sie auch vollautomatisch mit einem Dispense Arm. Dieser fährt dabei über den Chuck und verteilt eine definierbare Menge.

Das Gerät ist mit einer Verriegelung der Abdeckung, einem vollgrafischen Touch-Panel und dazugehöriger Visualisierung ausgestattet. Die Belackungsschleuder M-Spin 200 besteht aus einem Einbaumodul, welches über ein flexibles Kabel mit der externen Steuerung in einem 19" Gehäuse verbunden ist.



M-Spin 200 Spin Coater

The spin coater M-Spin 200 serves to homogeneously laquer, develop and dry wafers or substrates. The spin coater is suitable for wafer-diameters up to 8" or for substrates up to 6" x 6".

Optionally it works completely automatically with a dispense arm. Therefore this arm moves over the chuck and spreads a scaleable amount.

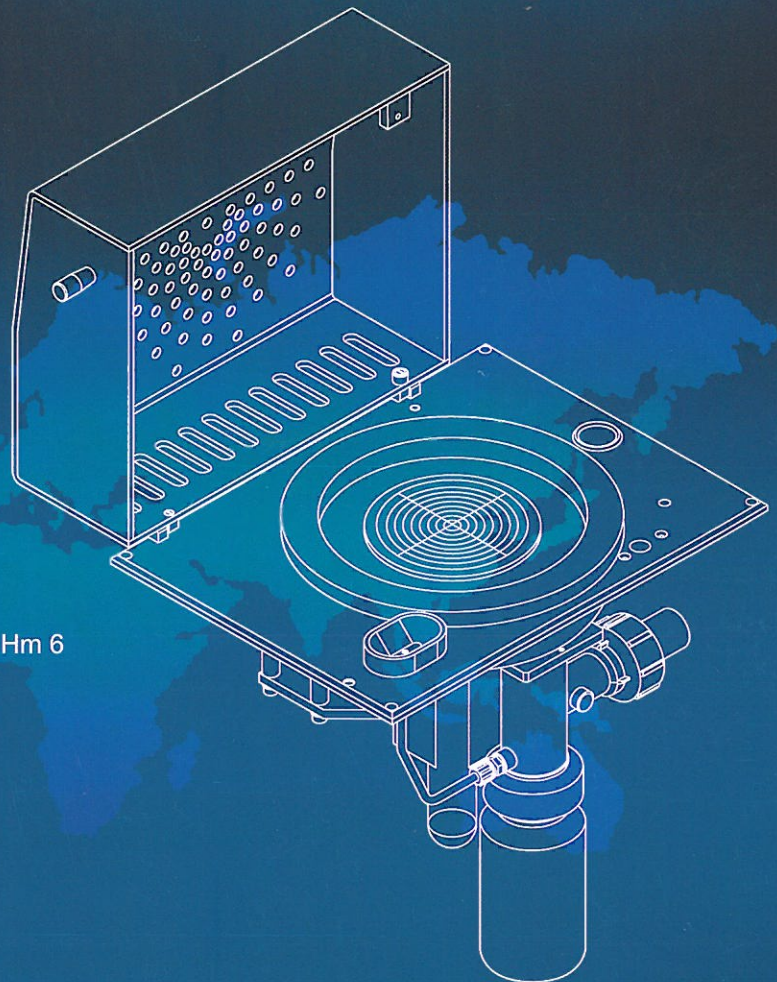
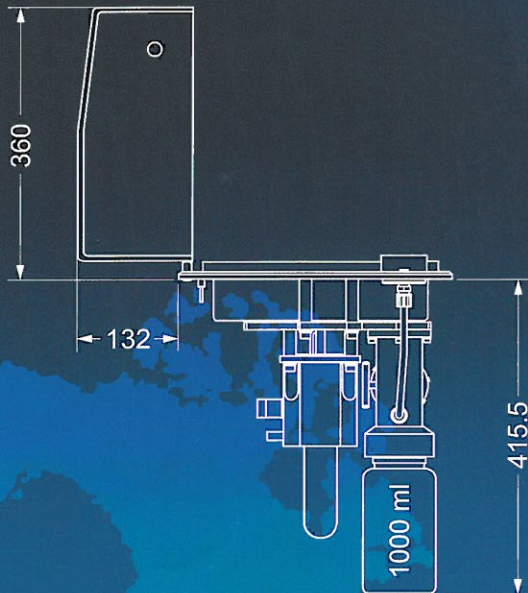
The unit is equipped with a locking mechanism for the lid, a completely graphical touch-panel with corresponding visualisation. The spin coater M-Spin 200 consists of an integrable module, which is connected to the external 19" controller unit over a flexible wire.

Technical Data

Wafer sizes	Wafer diameters up to 8" / Substrates up to 6" x 6"
Rotation speed	up to 9.000 rpm (adjustable in 1 rpm steps)
Holding device for wafer / substrate	Vacuum chuck
Programmable parameters	Process time (1-999 sec., adjustable in 1 sec. steps)
Programmable acceleration ramp	1 - 5.000 rpm/sec.
Freely programmable	20 programs each with 40 steps
Dimensions spin coater, without lid L x W x H (mm).....	approx. 480 x 360 x 416
Dimensions controller L x W x H (mm)	approx. 145 x 100 x 120
Options	chucks in various sizes / low contact chucks / dispense arm table top cabinet / dosing pump / stand alone version

Abmessungen Belackungsschleuder M-Spin 200

Dimensions Spin Coater M-Spin 200



DIN 974 - Hm 6

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Weiteres Lieferprogramm

Hotplate
Wetbenches / Digestorien
Einbaukomponenten für Wetbenches / Digestorien
Automatisierung
Anlagen für Wafer-/Substratbearbeitung
Wafer-/Substrat-Handhabung
Rinser Dryer / Dryer / Einzelscheibenschleuder
Teilereinigung / Quarzteilereinigung
Medienver- / entsorgungsstationen
Reinraum- / Laboreinrichtungen
Galvanikanlagen
Zubehör

Additional Product Line

Hotplate
Wetbenches / Digestorien
Install Components for Wetbenches / Digestorien
Automatization
Plants for Treatment of Wafer / Substrates
Handling of Wafer / Substrates
Rinser Dryer / Dryer / Single-Wafer-Centrifugal
Parts Cleaning / Quartzparts Cleaning
Media Supply / Disposal Stations
Cleanroom / Lab Equipment
Electroplating Plants
Accessories